

**聯繫:**

投資者關係

陳瑛, +86-21-3882-9909, 分機 66770

錢蕾, +86-21-3882-9909, 分機 66088

ir@hhgrace.com

## 新聞稿

### 華虹半導體二零一四年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。  
本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國上海—2014年11月5日—全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司(香港聯交所股票代號: 1347) (「本公司」)於今日公佈截至二零一四年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

#### 二零一四年第三季摘要

- 二零一四年第三季度銷售額為 1.740 億美元，較二零一三年第三季度增長 9.8%，較二零一四年第二季度減少 1.6%。
- 二零一四年第三季度毛利率為 32.2%，高於二零一四年第二季度的 31.0%。
- 二零一四年第三季度淨利潤為 2,910 萬美元，相比二零一四年第二季度的 2,440 萬美元增長了 19.1%，相比二零一三年第二季度增長了 133.0%。
- 二零一四年第三季度嵌入式非易失性存儲器產品銷售額增長至佔總銷售額的 43.5%，高於二零一四年第二季度的 41.0%。

華虹半導體總裁兼執行董事王煜先生說，“在第三季度，我們的收入達到了 1.74 億美元，毛利率也達到了 32.2% 的歷史高點。

二零一四年第三季度的產能利用率為 96.1%，二零一四年第二季度為 97.6%。銷售額季度環比雖下降 1.6%，但毛利率增長至 32.2% 的歷史高點，淨利潤季度環比增長了 19.1%。本季度的強勁表現大部份得益於中國市場的智慧卡、微控制器及功率器件的持續成長。

我們將持續改進產品結構，專注于高利潤率和高增長性的機會。我們對於全球半導體行業的總體前景持十分樂觀的態度，尤其在中國，為此我們開始增加產能，並持續投入對先進特色工藝的研究與開發。

展望未來，我們對特色工藝的持續專注，尤其是 0.13 微米及以下的先進技術節點，將有助於公司的收入增長和高利潤率的保持。

來自中國晶片市場，尤其是智慧卡市場的強勁需求將持續推動我們的成長，我們的銷售收入比例中，來自中國客戶的收入有望一直保持在超過 50% 的水準。”

## 電話會議公告

日期：二零一四年十一月六日

時間：上海時間上午十時

電話：	國際	+61 283 733 610
	中國	+86 800 870 0210 +86 400 120 3170
	香港	+852 3051 2792
	臺灣	+886 2 7743 8419
	美國	+1 845 507 1610
	新加坡	+65 3158 0667

密碼 HUAHONG

該電話會議的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿發佈後12個月內刊登於華虹半導體的網站上。

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司(「本公司」，香港聯交所代號: 1347)是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的 200mm 晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化的客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致完善的複雜設計。

詳細資訊請參考華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

二零一四年第三季度經營業績概要  
以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第三季度 (未經審核)	同比
銷售收入	174,002	176,880	-1.6%	158,509	9.8%
銷售成本	(117,966)	(122,021)	-3.3%	(134,884)	-12.5%
<b>毛利</b>	<b>56,036</b>	<b>54,859</b>	<b>2.1%</b>	<b>23,625</b>	<b>137.2%</b>
<b>毛利率</b>	<b>32.2%</b>	<b>31.0%</b>	<b>1.2%</b>	<b>14.9%</b>	<b>17.3%</b>
經營開支	(23,308)	(25,345)	-8.0%	(14,776)	57.7%
其他收入(開支)，淨額	4,861	2,072	134.6%	3,667	32.6%
<b>稅前溢利</b>	<b>37,589</b>	<b>31,586</b>	<b>19.0%</b>	<b>12,516</b>	<b>200.3%</b>
所得稅開支	(8,476)	(7,140)	18.7%	(2)	423700.0%
<b>期內溢利</b>	<b>29,113</b>	<b>24,446</b>	<b>19.1%</b>	<b>12,514</b>	<b>132.6%</b>
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	29,113	24,446	19.1%	12,514	132.6%
非控制權益	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利					
基本	0.04	0.03	-	0.02	-
攤薄	0.04	0.03	-	0.02	-
付運晶圓(仟片/約當 8 吋)	372	377	-1.3%	335	11.0%
產能利用率 <sup>1</sup>	96.1%	97.6%	-1.5%	94.7%	1.4%

- 二零一四年第三季度銷售收入為 1.740 億美元，較二零一三年第三季度增長 9.8%，較二零一四年第二季度的 1.769 億美元減少 1.6%。
- 二零一四年第三季度銷售成本為 1.180 億美元，較二零一四年第二季度的 1.220 億美元減少 3.3%。
- 二零一四年第三季度毛利為 5,600 萬美元，較二零一四年第二季度的 5,490 萬美元增長 2.1%。
- 二零一四年第三季度毛利率由二零一四年第二季度的 31.0% 增至 32.2%，主要是由於高產能利用率、由嵌入式非易失性存儲器產品推動的產品結構優化，以及折舊及攤銷費用的減少。
- 二零一四年第三季度經營開支由二零一四年第二季度的 2,530 萬美元降低至 2,330 萬美元，得益於我們持續的成本控制舉措。

<sup>1</sup> 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

#### 銷售收入分析

按類別劃分的銷售收入	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
晶圓	96.4%	97.0%	95.9%
其他	3.6%	3.0%	4.1%
<b>銷售收入總額</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

- 我們 95.0% 以上的銷售收入繼續主要來源於半導體晶圓的直接銷售。

#### 銷售收入分析

按地域劃分的銷售收入	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
中國 <sup>2</sup>	52.7%	54.8%	48.2%
美國	23.0%	22.3%	27.5%
日本 <sup>3</sup>	5.1%	5.2%	9.8%
亞洲 <sup>4</sup>	9.9%	9.5%	7.0%
歐洲	9.3%	8.2%	7.5%
<b>銷售收入總額</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

- 在二零一四年第三季度期間，中國仍是我們最大的市場，其貢獻的銷售收入佔我們銷售收入總額的約 52.7%。同時，我們的第二大市場（美國）貢獻的銷售收入佔我們銷售收入總額的 23.0%。

#### 銷售收入分析

按技術平臺劃分的銷售收入	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
嵌入式非易失性存儲器	43.5%	41.0%	35.0%
邏輯及射頻	11.5%	14.9%	20.3%
分立器	20.4%	20.1%	20.8%
模擬與電源管理	15.8%	14.2%	12.9%
獨立非易失性存儲器	8.0%	9.1%	10.0%
其他	0.8%	0.7%	1.0%
<b>銷售收入總額</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

- 在二零一四年第三季度期間，我們的嵌入式非易失性存儲器產品銷售收入佔銷售收入總額的比例由二零一四年第二季度的 41.0% 增長至 43.5%。

<sup>2</sup> 包括香港。

<sup>3</sup> 包括於歷史記錄期內由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

<sup>4</sup> 不包括中國及日本。

#### 銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
0.13 $\mu$ m 及以下	39.4%	39.0%	32.5%
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	18.7%	20.5%	24.8%
0.25 $\mu$ m	1.0%	0.7%	1.5%
0.35 $\mu$ m 及以上	40.9%	39.8%	41.2%
<b>銷售收入總額</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

- 我們一直策略性地專注於更先進的技術節點，如 0.13  $\mu$ m、0.11  $\mu$ m 及 90nm。因此，來源於 0.13  $\mu$ m 及以下技術節點的產品銷售收入佔比在二零一四年第三季度有了進一步的增長，由二零一四年第二季度的 39.0% 增至 39.4%。

#### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
電子消費品	48.7%	51.2%	45.5%
通訊	29.8%	27.5%	30.5%
計算機	11.2%	9.2%	13.8%
工業及汽車	10.3%	12.1%	10.2%
<b>銷售收入總額</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

- 電子消費品及通訊分別為我們最大及第二大的終端市場分佈，在二零一四年第三季度貢獻的銷售收入超過我們總銷售收入的 75%。

#### 產能<sup>5</sup>及產能利用率

晶圓廠 (仟片晶圓每月)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	二零一三年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	50	50	50
2 號晶圓廠	39	34	34
3 號晶圓廠	40	40	40
<b>總估計月產能</b>	<b>129</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
產能利用率	<b>96.1%</b>	<b>97.6%</b>	<b>94.7%</b>

- 我們在二零一四年第三季度的月產能由二零一四年第二季度的 12.4 萬片 8 吋等值晶圓提高至 12.9 萬片 8 吋等值晶圓。

<sup>5</sup> 在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

8吋等值晶圓 (仟片晶圓)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第三季度 (未經審核)	同比
付運晶圓	372	377	-1.3%	335	11.0%

- 付運晶圓量在二零一四年第三季度與二零一四年第二季度相比保持穩定，而相較二零一三年第三季度則上升了 11.0%，主要是由於客戶需求的增加。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第三季度 (未經審核)	同比
銷售及分銷費用	1,558	1,772	-12.1%	1,927	-19.1%
管理費用 <sup>6</sup>	21,750	23,573	-7.7%	12,849	69.3%
<b>經營開支</b>	<b>23,308</b>	<b>25,345</b>	<b>-8.0%</b>	<b>14,776</b>	<b>57.7%</b>

- 二零一四年第三季度經營開支由二零一四年第二季度的 2,530 萬美元下降至 2,330 萬美元，得益於我們持續的成本控制舉措。
- 二零一四年第三季度銷售及分銷費用由二零一四年第二季度的 180 萬美元下降至 160 萬美元，降幅為 12.1%，仍是得益於我們持續的成本控制舉措。
- 二零一四年第三季度管理費用由二零一三年第三季度的 1,280 萬美元增加至 2,180 萬美元，主要由於：(1) 勞工開支因薪資及社保增加而上升，(2) 上市費用，(3) 向一家關聯公司租賃宿舍新增租金。與二零一四年第二季度相比，管理費用下降了 7.7%，主要得益於我們持續的成本控制舉措。

### 其他收入(開支)淨額分析

以千美元計	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第三季度 (未經審核)	同比
其他收入及收益	6,266	4,981	25.8%	7,179	-12.7%
-租金收入	3,251	3,169	2.6%	3,305	-1.6%
-利息收入	1,299	975	33.2%	1,891	-31.3%
-政府補貼	60	-	100.0%	-	100.0%
-匯兌收益	-	-	-	539	-100.0%
-其他	1,656	837	97.9%	1,444	14.7%
投資物業的公平值收益	-	412	-100.0%	4	-
財務費用	(2,958)	(3,020)	-2.1%	(4,148)	-28.7%
分佔一家聯營公司溢利	1,591	-	100%	632	151.7%
其他費用 <sup>7</sup>	(38)	(301)	-87.4%	-	-100.0%
<b>其他收入(開支)淨額</b>	<b>4,861</b>	<b>2,072</b>	<b>134.6%</b>	<b>3,667</b>	<b>32.6%</b>

- 二零一四年第三季度其他收入(開支)淨額由二零一四年第二季度的 210 萬美元增加至 490 萬美元，主要由於利息收入及分佔一家聯營公司溢利的增加。

<sup>6</sup>管理費用包括確認為研發開支的政府補助的抵消項目。

<sup>7</sup>包含各項雜費及匯兌損失。

**流動性概述 (以千美元計)**

	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)	於六月三十日 二零一四年 (已經審核)
存貨	84,924	81,353
貿易應收款項及應收票據	113,867	126,437
預付款項、按金及其他應收款項	5,235	5,134
應收關聯方款項	51,561	55,638
已抵押存款及定期存款	12,586	15,368
現金及現金等價物	342,399	298,136
<b>流動資產總額</b>	<b>610,572</b>	<b>582,066</b>
貿易應付款項	62,571	62,287
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	69,375	78,546
計息銀行及其他借款	100,982	100,980
政府補助	51,938	48,567
應付關聯方款項	16,566	20,761
應付所得稅	18,326	12,718
<b>流動負債總額</b>	<b>319,758</b>	<b>323,859</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>290,814</b>	<b>258,207</b>
速動比率	1.6x	1.6x
流動比率	1.9x	1.8x

- 於二零一四年第三季度末，現金及現金等價物增加主要由於：(1) 於二零一四年第三季度收回了二零一四年第一季度及第二季度因銷售收入較高而產生的貿易應收款項及應收票據；(2) 於二零一四年第三季度收到了政府補助。
- 二零一四年第三季度末流動負債較二零一四年第二季度末略有下降，是由於其他應付款項及應付關聯方款項的減少所致。
- 於二零一四年第三季度末，淨營運資金為 2.908 億美元。二零一四年第三季度及二零一四年第二季度的流動比率分別為 1.9 倍及 1.8 倍。

### 資本結構 (以千美元計)

	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)	於六月三十日 二零一四年 (已經審核)
現金及現金等價物	342,399	298,136
已抵押存款及定期存款	12,586	15,368
短期借款	100,982	100,980
長期借款	244,780	244,777
負債	345,762	345,757
權益	1,120,214	1,091,347
資本負債比率 <sup>8</sup>	-0.8%	3.0%

### 現金流量概要(以千美元計)

	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
經營活動所得現金流量淨額	64,944	45,130
投資活動所用現金流量淨額	(18,884)	(23,733)
融資活動所用現金流量淨額	(2,903)	(22,844)
外匯匯率變動影響淨額	1,106	1,764
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>44,263</b>	<b>317</b>

- 二零一四年第三季度經營活動所得現金流量淨額為 6,490 萬美元；投資活動所用現金流量淨額為 1,890 萬美元，主要用於採購機器設備；融資活動所用現金流量淨額為 290 萬美元，主要用於支付銀行貸款利息。

### 資本開支概要

- 二零一四年第三季資本開支為 1,890 萬美元，較二零一四年第二季資本開支 2,370 萬美元減少了 20.3%。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)

<sup>8</sup> (銀行借款及其他借款總額 - 現金及現金等價物以及已抵押存款及定期存款) / 總權益

華虹半導體有限公司  
綜合損益表  
(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
銷售收入	174,002	176,880
銷售成本	(117,966)	(122,021)
<b>毛利</b>	<b>56,036</b>	<b>54,859</b>
其他收入及收益	6,266	4,981
投資物業的公平值收益	-	412
銷售及分銷費用	(1,558)	(1,772)
管理費用	(21,750)	(23,573)
其他費用	(38)	(301)
財務費用	(2,958)	(3,020)
分佔一家聯營公司溢利	1,591	-
<b>稅前溢利</b>	<b>37,589</b>	<b>31,586</b>
所得稅開支	(8,476)	(7,140)
<b>期內溢利</b>	<b>29,113</b>	<b>24,446</b>
以下各方應佔利潤：		
母公司擁有人	29,113	24,446
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.04	0.03
攤薄	0.04	0.03
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>805,176,000</b>	<b>805,176,000</b>
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>805,176,000</b>	<b>805,176,000</b>

華虹半導體有限公司  
綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至	
	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)	於六月三十日 二零一四年 (已經審核)
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	569,881	571,964
投資物業	189,782	189,773
預付土地租賃款項	24,241	24,419
無形資產	13,645	14,272
於聯營公司的投資	43,045	41,261
可供出售投資	229,254	229,245
長期預付款項	5,852	5,595
遞延稅項資產	8,391	8,391
<b>非流動資產總額</b>	<b>1,084,091</b>	<b>1,084,920</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	84,924	81,353
貿易應收款項及應收票據	113,867	126,437
預付款項、按金及其他應收款項	5,235	5,134
應收關聯方款項	51,561	55,638
已抵押存款及定期存款	12,586	15,368
現金及現金等價物	342,399	298,136
<b>流動資產總額</b>	<b>610,572</b>	<b>582,066</b>
<b>流動負債</b>		
貿易應付款項	62,571	62,287
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	69,375	78,546
計息銀行及其他借款	100,982	100,980
政府補助	51,938	48,567
應付關聯方款項	16,566	20,761
應付所得稅	18,326	12,718
<b>流動負債總額</b>	<b>319,758</b>	<b>323,859</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>290,814</b>	<b>258,207</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>1,374,905</b>	<b>1,343,127</b>
<b>非流動負債</b>		
計息銀行及其他借款	244,780	244,777
遞延稅項負債	9,911	7,002
<b>非流動負債總額</b>	<b>254,691</b>	<b>251,779</b>
<b>淨資產</b>	<b>1,120,214</b>	<b>1,091,348</b>
<b>權益和負債權益</b>		
股本	1,229,996	1,229,996
儲備	(109,782)	(138,648)
<b>權益總額</b>	<b>1,120,214</b>	<b>1,091,348</b>

華虹半導體有限公司  
綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 九月三十日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>		
期內溢利	29,113	24,446
折舊及攤銷	17,641	23,610
應佔聯營公司溢利	1,591	-
營運資金的變動及其它	16,599	(2,926)
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>64,944</b>	<b>45,130</b>
<b>投資活動所得現金流量:</b>		
購買物業、廠房及設備項目	(18,884)	(23,733)
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(18,884)</b>	<b>(23,733)</b>
<b>融資活動所得現金流量:</b>		
償還銀行貸款	-	(19,592)
已付利息	(2,903)	(3,252)
<b>融資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(2,903)</b>	<b>(22,844)</b>
現金及現金等價物增加(減少)淨額	43,157	(1,447)
外匯匯率變動影響淨額	1,106	1,764
期初現金及現金等價物	298,136	297,819
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>342,399</b>	<b>298,136</b>

於本公告日期，本公司董事分別為:

**執行董事**

傅文彪(董事長)  
王煜(總裁)

**非執行董事**

陳劍波  
馬玉川  
森田隆之  
葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同  
王桂壩太平紳士  
葉龍蜚

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
傅文彪  
董事長兼執行董事

中國上海  
二零一四年十一月五日

\* 僅供識別